

成都青洋电子材料有限公司

崇州青洋电子半导体单晶硅片生产线技改扩能项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

成都青洋电子材料有限公司在成都崇州经济开发区泗维路 265 号建设“崇州青洋电子半导体单晶硅片生产线技改扩能项目”，该项目于 2024 年 12 月委托四川省衡信环保技术有限公司进行了环境影响评价工作，并于 2024 年 12 月 30 日取得了成都市生态环境局关于该项目环境影响报告书的批复（成环审（评）[2024]90 号）；该项目由于市场原因取消了“新增产品后续的光亮腐工序”的建设（情况说明见附件），即该项目只安装了超声波清洗机 1 台、研磨机 5 台、多功能晶片分选机 2 台；全自动酸腐机及为酸腐工序配套的酸性废气处理系统（碱液喷淋+碱液喷淋+水洗喷淋+15m 高排气筒）、含氟废水处理系统均未建设，建成后新增年产半导体单晶硅片 1000 万片均为研磨后的半导体单晶硅片产品（均不进行光亮腐工序），本项目建成后全厂产能达到 3000 万片/a 的生产能力；该项目 2026 年 2 月开工建设，设备及环保设施于 2026 年 4 月 6 日建成，于 2026 年 4 月 6 日至 2026 年 8 月 6 日进行竣工调试，并对竣工日期、调试日期进行了公示。

经现场查看，目前，项目主体工程 and 环保设施运行正常，现有的环境保护设施的设计符合环境保护实际规范的要求。成都青洋电子材料有限公司落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

成都青洋电子材料有限公司崇州青洋电子半导体单晶硅片生产线技改扩能项目在建设过程中基本落实了环境影响报告书及审批部门审批决定（成环审（评）[2024]90 号）中提出的环境保护对策措施，具体落实情况对照表见下表：

表 1 环评落实情况

项目	环评要求	实际建设情况
废水	项目运营期加强废水收集处理，确保稳定达标排放。按照废(污)水分类收集、分质处理的原则，非含氟废水依托现有悬浮废水处理系统，采用“斜管添加絮凝剂沉淀”工艺预处理；含氟废水、废气喷淋废水经本	项目取消了光亮腐工序，含氟废水、废气喷淋废水不增加，环评中新增的含氟废水处理系统未建设；其余已落实。

	次新增的含氟废水处理系统，采用“调节+石灰法+絮凝沉淀法”工艺预处理；生活污水(食堂废水先经隔油处理)经预处理池处理；上述预处理后的废水，与纯水制备废水一并于厂区废水总排口达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1“电子专用材料间接排放标准”后，通过园区污水管网进入崇州市经开区污水处理厂进一步处理，尾水排入西河。	
废气	项目运营期严格废气收集处理措施和加强设施的运维管理，确保稳定达标排放。 新增全自动酸腐机为密闭设备，产生的酸性废气经设备集气口（3个）连接管道收集；酸洗工序产生的酸性废气经酸洗槽槽体上方设置的集气罩收集；上述收集的废气一并引至新建的1套“碱喷淋+碱喷淋+水喷淋”装置（TA005）处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）后，由1根15m高排气筒（DA005）排放。	项目取消了光亮腐工序，酸性废气处理系统未建设。
	依托现有工程生产线进行粘胶、去胶，粘胶、去胶均于密闭隔间内进行，产生的废气经操作台或清洗槽上方设置的集气罩收集至现有1套“两级活性炭吸附”装置处理达《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)后，由1根15m排气筒(DA002)排放。	已落实。 依托现有工程已建的有机废气处理设施。
	同时，严格落实报告书提出的有关防护距离及防控要求，有效控制无组织排放废气对周边环境的影响，防护距离内不得规划建设环境敏感保护对象。	已落实。 卫生防护距离内未涉及敏感保护目标。
噪声	强化噪声污染防治，落实各项噪声治理措施，确保噪声达标排放。	已落实。 设备安装在厂房内，选用低噪设备、设备减振、厂房隔声等
固废	严格落实一般固体废物、危险废物的分类收集、暂存、处置的环境管理要求。建设单位应按照国家相关管理规范，依法向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。其中，含氟废水处理系统污泥须进行危险废物鉴别。在鉴别完成前，作为危废暂存在危废暂存间内，交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置。若经鉴别属于危险废物须交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置；若不属于危险废物，则按一般固废处置。	已落实。 不合格原料、滚磨废渣交硅棒供应商回收；研磨废渣、预处理池污泥、悬浮废水处理系统污泥、含氟废水处理系统污泥交由夹江眉乐环保科技有限公司处置；废设备耗材交废品回收站回收；废氮气钢瓶由氮气供应商回收；废活性炭、废化学品包装暂存在危废暂存间内，集中收集后交四川省中明环境治理有限公司进行处置；本项目不增加含氟废水处理系统污泥。
土壤和地	严格落实地下水 and 土壤污染防治措施，加强监控管理以防范土壤和地下水污染。	已落实。同环评

下水		
环境 风险 措施	落实报告书中各项环境风险防范措施，建立完善环境风险防范制度。该项目所属行业纳入四川省突发环境事件应急预案备案名录，须按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》，根据实际编制或修订突发环境事件应急预案并及时备案，认真落实环境安全隐患排查及应急措施的管理，切实防范突发环境事件。同时，对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育，开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，建立隐患整改台账，及时消除隐患。	突发环境事件应急预案正在进行修订，其余已落实。

1.3 验收过程简况

崇州青洋电子半导体单晶硅片生产线技改扩能项目位于成都崇州经济开发区泗维路 265 号，公司委托四川省衡信环保技术有限公司编制完成了《成都青洋电子材料有限公司崇州青洋电子半导体单晶硅片生产线技改扩能项目环境影响报告书》，并取得了成都市生态环境局出具的批复，批复文号：成环审（评）[2024]90 号。该项目由于市场原因取消了“新增产品后续的光亮腐工序”的建设（情况说明见附件），新增的超声波清洗机、研磨机、多功能晶片分选机已安装，并利用现有工程的钻石线切机、倒角机、研磨机等生产设备，通过使用钨丝金刚线替换硅片线切过程中的钻石金刚线提高线切机的运转速度，从而提高线切能力，建成后新增年产半导体单晶硅片 1000 万片均为研磨后的半导体单晶硅片产品（均不进行光亮腐工序），全厂半导体单晶硅片产能由现有 2000 万片/年增至 3000 万片/年。该项目 2026 年 2 月开工建设，设备及环保设施于 2026 年 4 月 6 日建成，于 2026 年 4 月 6 日至 2026 年 8 月 6 日进行竣工调试。本项目验收监测报告表于 2026 年 6 月编制并最终修订完成。

2.其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

成都青洋电子材料有限公司成立了环保机构，开展全面、全员、全过程的环境管理和环保技术监督工作。配置了环保管理人员，主要负责全公司日常管理及各项管理制度的制定，执行、检查、考核与完善。公司制定了《环境保护管理制度》，在《环境保护管理制度》中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职

责、明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。与项目有关的各项环保档案资料（环评报告表、环评批复、环保设备档案等）由办公室保管，环保设施运行及维修记录由办公室保管。

（2）环境风险防范措施

成都青洋电子材料有限公司已按环评要求设置消防栓、灭火器、防火标识等。在突发事故发生时，可起到一定应急作用。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目技改扩能完成后，卫生防护距离为原环评中划定的卫生防护距离范围，即以生产车间为边界设置 **100m** 的卫生防护距离，项目周边为工业企业，卫生防护距离内无居民、学校、食品加工、制药等环境敏感目标，项目不涉及环境搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目周边无珍惜动植物保护区，不涉及其他需要保护的区域。